

Известия высших учебных заведений ЭЛЕКТРОНИКА

Том 22 № 4
2017 июль—август

Научно-технический журнал

Издается с 1996 г.

Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Технологические процессы и маршруты

Белов А.Н., Перевалов А.А., Шевяков В.И. Мемристорные структуры для микро- и наноэлектроники. Физика и технология. Обзор. 305

Вигдорович Е.Н. Механизм формирования квантово-размерных слоев гетероструктур AlGaIn/GaN/InGaIn/GaN... 322

Волоховский А.Д., Герасименко Н.Н., Петраков Д.С. Применение комбинированных оптических методов для контроля процесса травления щелевой изоляции 331

Рябышенков А.С. Термодинамический анализ процесса воздухоподготовки чистых помещений 341

Элементы интегральной электроники

Сергеев В.А., Тетенькин Я.Г. Оценка адекватности тепловой модели КМОП цифровых интегральных схем по переходным тепловым характеристикам 350

Кононов В.С., Шелепин Н.А. Повышение эффективности моделирования переходных процессов в КМОП-микросхемах с учетом одиночных радиационных эффектов 361

Схемотехника и проектирование

Гаврилов С.В., Карева Е.С., Рыжова Д.И. Алгоритмы логико-топологического синтеза библиотечных элементов и блоков с регулярной структурой для технологических норм проектирования 32 нм 369

<i>Булах Д.А., Казённов Г.Г., Лапин А.В.</i> Использование модификации алгоритма работы сетей Петри для функционального моделирования логических схем, представленных на вентильном уровне	379
--	-----

Микро- и наносистемная техника

<i>Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П.</i> Влияние параметров конструкции актюаторов на чувствительность частотных микроакселерометров	386
--	-----

Краткие сообщения

<i>Кондратьев П.К.</i> Методика регулирования концентрации углеродных нанотрубок при формировании композитной металлизации ИС	398
---	-----

<i>Тимошенков В.П., Фатеев И.А.</i> DICE КМОП КНИ-триггер, устойчивый к воздействию тяжелых заряженных частиц для применения в приемных трактах	402
---	-----

К сведению авторов	407
--------------------------	-----